

1-87230-0 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 公端

TE 内部编号 1-87230-0

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 20 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Unshrouded, Gold (Au), Through Hole - Solder, AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **板对板**

位数: 20

行数: 2

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	不带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
板对板配置	垂直
PCB 安装方向	直角
位数	20
行数	2

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 Vrms

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性



	15 µin
端子底板材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	.381 µm[15 µin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.79 mm[.11 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]

使用环境

壳体温度额定值	标准
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------



UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	25
封装方法	Tray

产品合规性

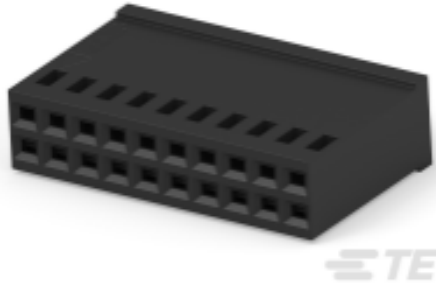
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

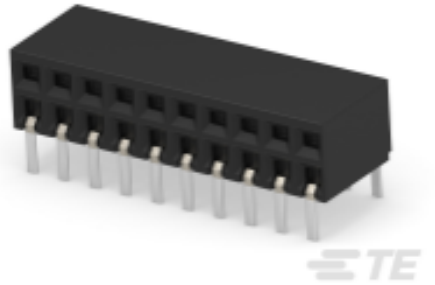
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

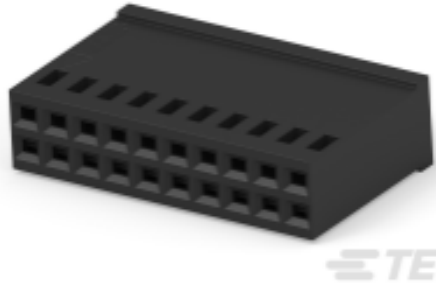
配套部件



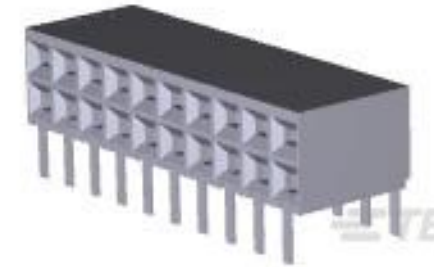
TE 产品编号 1-87456-6
20 MODIV HSG DR MRKD .100CL



TE 产品编号 5535512-2
20 MODII HORZ DR CE



TE 产品编号 1-87456-5
20 MODIV HSG COMP DR .100CL

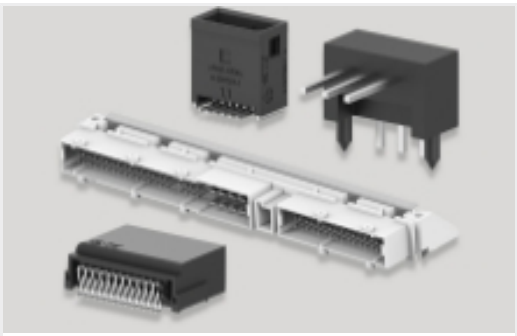


TE 产品编号 5146140-9
20 MODII HORZ DR CE 100CL

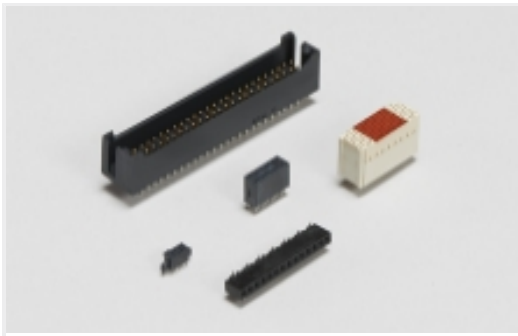


TE 产品编号 86177-1
20 MODIV HSG COMP DR .100CL

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端



PCB 板端连接器及母端(1623)



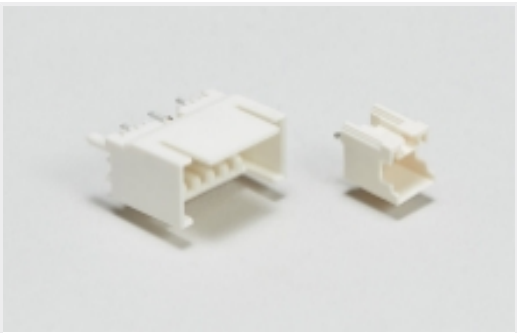
板对板接头和插座(1579)



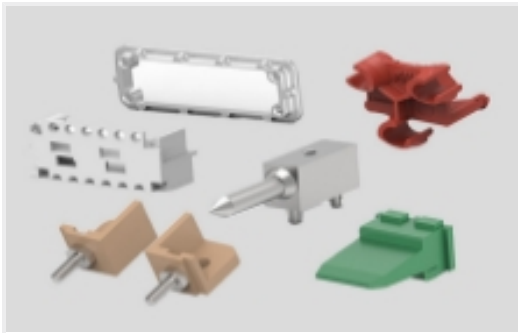
汽车接头(1)



矩形电源连接器(43)



线对板接头和插座(113)



连接器硬件(1)



连接器端子(47)

客户还购买了



TE 产品编号 LICAL-EDC-DS001
TRANSCODER DS IC CHIP RC
PROTOCOL T&R



TE 产品编号 87230-3
06 MODII HDR DRRA UNSHRD .100



TE 产品编号 87230-4
08 MODII HDR DRRA UNSHRD .100



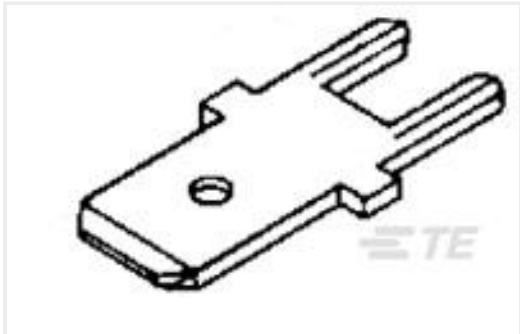
TE 产品编号 87230-6
12 MODII HDR DRRA UNSHRD .100



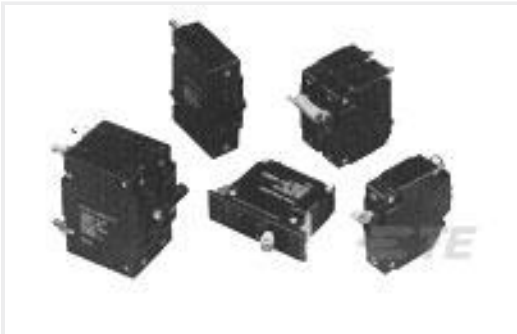
TE 产品编号 87230-9
18 MODII HDR DRRA UNSHRD .100



TE 产品编号 292303-1
Std USB Type A, R/A, T/H



TE 产品编号 726386-2
250 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号 4-1393253-0
W68-X2Q12-7=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号1-1623927-9
[CFR16 5% 180R](#)



TE 产品编号4-1879214-9
[CPF 0402 1K07 0.1% 25PPM 1K RL](#)

文档

产品图纸

[20 MODII HDR DRRR UNSHRD .100](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1-87230-0_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-87230-0_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-87230-0_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5](#)

英文版本